

Title (en)
Semiconductor circuit assembly

Title (de)
Halbleiterschaltungsanordnung

Title (fr)
Agencement de commutation semi-conducteur

Publication
EP 2343780 A1 20110713 (DE)

Application
EP 10192530 A 20101125

Priority
DE 102010000834 A 20100112

Abstract (en)
The assembly has a connecting device (1) provided with a contact section (2) and formed from a composite film. A connection element (3) is provided with a contact section (4). A housing includes a counter bearing (5) for supporting the contact sections. The contact sections and/or the counter bearing include respective contact areas (A, C, E, F), where the contact areas are different from each other. One of the superimposed arranged contact sections deforms when exercising clamping force, where the section is adapted to shape of the other contact section during an electrical contact.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Halbleiterschaltungsanordnung, umfassend eine aus einem Folienverbund gebildete Verbindungseinrichtung (1) mit einem ersten Kontaktabschnitt (2), ein Anschlusselement (3) mit einem zweiten Kontaktabschnitt (4), ein Gehäuse mit einem Widerlager (5) zum Abstützen einer der beiden Kontaktabschnitte (2, 4), und ein Mittel zur Erzeugung einer die Kontaktabschnitte (2, 4) gegeneinander zwingenden Klemmkraft. Zur Verbesserung der Stromtragfähigkeit des Kontakts wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass der erste Kontaktabschnitt (2) und/oder der zweite Kontaktabschnitt (4) und/oder das Widerlager (5) eine voneinander verschiedene Kontaktfläche (A, B, C, D, E, F) aufweist, so dass bei Ausübung der Klemmkraft zumindest einer der beiden übereinander angeordneten Kontaktabschnitte (2, 4) verformt und unter Ausbildung eines elektrischen Kontakts an die Form des anderen Kontaktabschnitts (2, 4) angepasst wird.

IPC 8 full level
H01R 4/18 (2006.01)

CPC (source: EP)
H01R 4/182 (2013.01); **H01R 4/188** (2013.01); **H01R 12/592** (2013.01)

Citation (applicant)
DE 102006027482 B3 20070816 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]

Citation (search report)
• [X] EP 1139492 A2 20011004 - SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]
• [X] EP 0286422 A2 19881012 - DU PONT [US]
• [X] DE 3937089 A1 19900510 - AMP INC [US]
• [X] WO 2007131537 A1 20071122 - FRAMATOME CONNECTORS INT [FR], et al
• [X] EP 0393927 A1 19901024 - AMP INC [US]
• [X] US 5743747 A 19980428 - SOBHANI MOHI [US]
• [X] DE 19905064 A1 19990812 - WHITAKER CORP [US]
• [X] US 6118666 A 20000912 - AOKI NOBUAKI [JP], et al

Cited by
DE102016104283B4; DE102014114828A1; DE102014114828B4; DE102016104283A1; US9661740B2

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2343780 A1 20110713; CN 102157486 A 20110817

DOCDB simple family (application)
EP 10192530 A 20101125; CN 201110020086 A 20110111